

Höchstleistungen, verpackt im eleganten Dress

Bei nur 32,5 x 22 x 21 cm (TBH) Größe, nimmt es dieses Mini-PC-Barebone im H7-Design auch mit den schnellsten Intel Core 2 Prozessoren mit zwei oder vier Kernen auf. Bis zu 16 GB DDR2-Speicher und gleich drei SATA2-Festplatten können verbaut werden. Das XPC Barebone SP45H7 setzt auf den Intel P45 Express Chipsatz, kommt mit Gigabit-LAN daher und bietet eine umfassende Anschlussvielfalt. Spezielle Optionen im BIOS ermöglichen hervorragende Möglichkeiten zur Feinabstimmung von Takt und Spannung. Das XPC Barebone SP45H7 überzeugt auf ganzer Linie - ob als Workstation im professionellen Umfeld oder mit großen Grafikkarten als Gaming-Cube.

XPC Barebone SP45H7



Hinweis: Das optische Laufwerk gehört nicht zum Lieferumfang. Die Abbildungen dienen nur zur Illustration.

Besondere Merkmale

H7-Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-Gehäuse (Schwarz) Schächte: 1x 5,25", 2x 3,5"
Chipsatz	<ul style="list-style-type: none"> Intel P45 Express + ICH10
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Sockel 775 Unterstützt Intel Core 2 Quad/Extreme/Duo, Pentium Dual-Core, Celeron 4xx Unterstützt 45 und 65nm CPUs Unterstützt bis zu 1600MHz FSB Shuttle I.C.E. Heatpipe Kühlsystem
Steckplätze	<ul style="list-style-type: none"> 1x PCI-Express x16 (V2.0), 1x PCI Unterstützt Dualslot-Grafikkarten
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützt 4x DDR2-667/800 Unterstützt insgesamt bis zu 16 GBytes
Laufwerksanschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> 3x SATA (intern) 3x External SATA (1x vorne, 2x hinten) 1x IDE ATA 133, 1x Diskettenlaufwerk
weitere Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> 7.1-Kanal Soundfunktion, SPDIF-Ausgang Firewire, GigaBit Netzwerk USB 2.0 (2x vorne, 4x hinten, 4x onb.)
Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> 300 Watt Mini-Netzteil (80 PLUS)
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> Performance

Artikelnummer: SP45H7
UPC (siehe Barcode)



Shuttle XPC Barebone SP45H7 – Top-Leistungsmerkmale



Neues H7-Design bietet mehr Erweiterungsmöglichkeiten

Die Abmessungen des neuen H7-Designs haben gegenüber dem G-Design etwas zugenommen und bieten im Gegenzug ein Plus an Erweiterungsmöglichkeiten. Der Netzteil-Lüfter ist nun 5cm groß und sorgt für leiseren Betrieb und besseren Luftstrom. Auf der Rückseite befinden sich nun zwei Perforationen für optionale Erweiterungen mit PS/2- und Parallel-Ports. Auf der Vorderseite befindet sich nun auch ein externer Serial-ATA-Anschluss. Das Mainboard-Design wurde modifiziert, so dass jetzt Doppelslot-Grafikkarten und bis zu 4 Speichermodule Platz finden.

Unterstützt Quadcore, 1600 MHz FSB und 45nm CPUs

Dieses Shuttle Produkt unterstützt Intel® Core™ 2 Duo und Intel® Core™ 2 Quad Prozessoren mit bis zu 1600 MHz Front Side Bus in der stromsparenden 45nm Fertigungstechnologie. Je mehr CPU-Kerne, desto mehr Leistung.

Dynamisches Übertakten (D.O.C.) *)

Dies ist eine im BIOS-Setup einstellbare Übertaktungsfunktion, die automatisch die CPU-Taktfrequenz in Abhängigkeit von der Belastung verändern kann. Falls eine erhöhte CPU-Auslastung festgestellt wird, dann wird die Taktfrequenz automatisch etwas angehoben, damit die Programm flüssiger und schneller laufen. Falls sich die CPU im Ruhemodus befindet oder nur wenig beansprucht wird, dann wird die Taktfrequenz auf einem normalen Wert belassen.

Dynamic Energy Saving (D.E.S.)

Diese Energiespar-Technologie verbessert die Energie-Effizienz des PC-Systems und vermindert die Hitzeentwicklung im PC-Gehäuse. Mit Hilfe eines speziellen Chips wird die CPU-Auslastung über das PSI-Signal der CPU (Power State Indicator) überwacht und bei geringer Belastung 3 der 4 Phasen des CPU-Spannungsreglers abgeschaltet. Diese fortschrittliche hardware-basierende Technologie spart nicht nur Energie, sondern führt auch zu einem geringeren Betriebsgeräusch.

Integrated Cooling Engine (I.C.E.)

Die Shuttle XPCs bieten die gleiche Leistungsfähigkeit wie herkömmliche Desktop-PCs, sind aber etwa dreimal kleiner. Damit bei diesem kleinen PC-Gehäuse eine ausreichende Kühlung gewährleistet werden kann, musste für den Shuttle XPC ein besonderes Kühlsystem entwickelt und integriert werden. Shuttles I.C.E.-Kühlsystem mit Heatpipe-Technologie ist eine ausgeklügelte Eigenentwicklung mit hoher Effizienz und sehr niedrigem Geräuschpegel.

PCI-Express V2.0 für schnelle Grafikkarten

Das Shuttle XPC Barebone SP45H7 kommt mit einem PCI-Express-V2.0-Steckplatz mit bis zu 16GB/s Datendurchsatz, was doppelt so viel ist, wie noch bei PCI-Express Version 1.0. Somit steht viel Potential für neueste Grafikkarten zur Verfügung, wobei dieser Standard abwärtskompatibel ist, also auch die meisten vorhandenen Grafikkarten weiterhin verwendet werden können.



**max.
4x 4GB = 16GB**

300W **80 PLUS**



Unterstützt große Dualslot-Grafikkarten

Das Shuttle XPC Barebone SG45H7 unterstützt große Dualslot-Grafikkarten wie z.B. ATI Radeon HD4870 oder NVIDIA Geforce GTX280, die wegen ihrer Breite gleich zwei Steckplätze belegen. Beachten Sie, dass bei Verwendung solch einer Grafikkarte der PCI-Steckplatz nicht mehr verwendet werden kann.

Unterstützt bis zu 16GB Systemspeicher

Dieser Shuttle XPC unterstützt bis zu 16GB DDR2-800 Speicher – ideal für eine High-end-Workstation mit 64-Bit Betriebssystem. Nutzen Sie die Vorteile einer High-Performance-Konfiguration voll aus!

80 PLUS® zertifiziertes Netzteil mit 300W

Mit dem 80 PLUS® Zertifikat werden Netzteile in Computern gekennzeichnet, deren Wirkungsgrad mindestens 80% beträgt. Der SG45H7 ist serienmäßig mit einem leistungsfähigen, stromsparenden 300W-Netzteil mit 80 PLUS® Zertifikat ausgestattet. Die neuen Netzteile in den Gehäusen der H7-Serie verfügen jetzt über einen 50mm-Lüfter. Dieser erzeugt den gleichen Luftstrom mit geringerer Drehzahl im Vergleich zu Vorgängermodellen mit 40mm.

Neue Shuttle Mainboard-Ära mit Feststoffkondensatoren

Durch die Verwendung von Feststoffelektrolytkondensatoren (All Solid Capacitors) macht Shuttle seine Mainboards für Gaming- und Multimedia-Anwendungen noch zuverlässiger und langlebiger! Die durchschnittliche Lebensdauer der neuen Kondensatoren ist mehr als sechs mal höher im Vergleich zu den sonst üblichen, billigeren Elektrolytkondensatoren.

External Serial ATA jetzt auch vorne

Zusätzlich zu den beiden eSATA-Anschlüssen auf der Rückseite bietet SG45H7 auch einen eSATA-Anschluss auf der Vorderseite. Somit lassen sich schnell externe High-Speed-Festplatten über diese schnelle Schnittstelle mit dem PC verbinden. Die Datenübertragungsrate von eSATA ist bis zu 3x schneller als USB 2.0.

Unterstützt Windows Vista Premium

Dieses Shuttle System unterstützt die benutzerfreundliche Windows Aero™ 3D-Oberfläche mit spektakulären visuellen Effekten, wie z.B. transparenten Bedienelementen. Windows® Vista™ verspricht Windows-Benutzern mehr Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht ein effizienteres Organisieren und Auffinden von Daten.

Shuttle XPC Zubehör

Shuttle bietet auch eine breite Palette an Zubehör für Komplettsysteme und XPC Barebones. Hierzu zählen z.B. WLAN-Modul oder Schnittstellen-Erweiterungen sowie eine XPC Tragetasche, die nicht nur vor Regentropfen schützt, sondern auch Stauraum für weitere Utensilien bietet.

*) Warnhinweis zur Übertaktung: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Übertakten (Overclocking) mit gewissen Risiken verbunden ist. Durch entsprechende Einstellung im BIOS oder durch Overclocking-Tools von Drittanbietern werden die Komponenten außerhalb ihrer zulässigen Spezifikation betrieben, was zu Instabilitäten und sogar zu dauerhaften Schäden an den Systemkomponenten führen kann. Shuttle lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch Übertaktung verursacht worden sind.

Shuttle XPC Barebone SP45H7 Spezifikation

Gehäuse	H7-Gehäusetypp aus Aluminium, Farbe: schwarz Laufwerksschächte: 1 x 5,25", 2 x 3,5" (davon 1 intern) verdeckte Laufwerksschächte Abmessungen: 32,5 x 20,8 x 18,9 cm (LBH), Gewicht: 3,6 kg netto / 5,0 kg brutto
Mainboard	Shuttle FP45, Shuttle Form Factor, spezielles Design für XPC SP45H7 Chipsatz: Intel P45 Express (MCH) + ICH10 (I/O Controller Hub) Mit Feststoffelektrolytkondensatoren (Solid Capacitors) – diese Kondensatoren sind hitzebeständiger und langlebiger
Netzteil	300 Watt Mini-Netzteil, unterstützt 100-240V AC Eingangsspannung 80 PLUS® zertifiziert (Wirkungsgrad 80% oder höher) Active PFC-Schaltung (Leistungsfaktor-Korrektur) Abmessungen: 19 x 8,2 x 4,3 cm (LBH)
Prozessor-Unterstützung	Socket 775 unterstützt Intel-Prozessoren mit Core-Technologie Unterstützt 1600, 1333, 1066 oder 800 MHz Front Side Bus (nicht 533MHz) Unterstützt Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Celeron Dual-Core, Celeron 4xx Unterstützt 65nm und 45nm Fertigungsstruktur Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste. Mainboard-BIOS unterstützt Dynamisches Übertakten *) **) Unterstützt Dynamic Energy Saving (D.E.S.) Technologie ***)
Prozessor-Kühlung	Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine) I.C.E. Heatpipe Kühl-Technologie mit linear geregelter 9,2cm Lüfter SilentX-Technologie für eine effizientere und leisere Kühlung
Speicher-Unterstützung	4 x 240 Pin Steckplätze, unterstützt Dual Channel Unterstützt DDR2-667/800 SDRAM Speicher maximal 4 GB per Steckplatz, bis zu einer Gesamtkapazität von 16 GB
Steckplätze	1x PCI-Express x16 V2.0 Steckplatz Unterstützt Dual-Slot Grafikkarten mit doppelter Slotbreite 1x PCI 32-Bit-Steckplatz8-Kanal Sound
8-Kanal Sound	7.1-Kanal HD-Audio (High Definition) mit Realtek ALC888 Codec Analog: Line-out (8-Kanal), Line-in, Mikrofon, CD-in, AUX Digital: optischer S/PDIF-Ausgang
Gigabit-Netzwerk Controller	Marvell 88E8056 Ethernet Netzwerk-Controller Mit PCI-Express Schnittstelle, konform zu IEEE 802.3u 1000Base-T Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Operation und Wake-on-LAN

<i>Firewire-Controller</i>	IEEE1394 Firewire Controller TI TSB43AB22A Konform zur 1394 OHCI Spezifikation rev. 1.0 1x 6pol. Firewire-Anschluss auf der Rückseite Unterstützt 400Mb/s, 200Mb/s, 100Mb/s Datentransferrate
<i>Anschlüsse Laufwerke</i>	Serial-ATA II, 3 Gb/s (300 MB/s) Datentransferrate 3x intern (SATA) und 3x extern (eSATA) 1x IDE ATA 100 Schnittstelle 1x Disketten-Schnittstelle
<i>Anschlüsse Vorderseite</i>	Mikrofon, Kopfhörer (Line-out), 2x USB 2.0 External Serial ATA Hotplug (eSATA) Ein/Aus-Button, Reset-Button Betriebsanzeige (blaue LED) Festplattenaktivitätsanzeige (orange LED)
<i>Anschlüsse Rückseite</i>	4x USB 2.0, Firewire (6 pin), GigaBit LAN (RJ45) 2x External Serial ATA Hotplug (eSATA) 8-ch Audio Line-out (2x rear/front, bass/center, surround/back), Audio Line-in Digital Audio: optischer S/PDIF-Ausgang Clear CMOS Button
<i>Optionale Anschlüsse Rückseite</i>	Wireless LAN Antenne (Perforation für PN20) PS/2-Maus und PS/2-Tastatur (Perforation für PS10) Parallele Schnittstelle (Perforation für PC8)
<i>Weitere Anschlüsse onboard</i>	6x USB 2.0 (drei Sets mit 2x5 Pins) 2x Lüfter-Anschlüsse (4 Pins und 3 Pins) Anschlüsse für PS/2-Maus und PS/2-Tastatur
<i>Zubehör</i>	Mehrsprachiges XPC Installations-Handbuch(En, De, Fr, Es, TC, Jp) XPC 32/64-Bit Treiber-CDROM für Windows XP/Vista Datenkabel: 1x Diskettenlaufwerk, 1x PATA, 2x SATA (PATA/SATA vorinstalliert) 230V-Netzkabel, Schrauben, Wärmeleitpaste

***) Warnhinweis zur Übertaktung**

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Übertakten (Overclocking) mit gewissen Risiken verbunden ist. Durch entsprechende Einstellung im BIOS oder durch Overclocking-Tools von Drittanbietern werden die Komponenten außerhalb ihrer zulässigen Spezifikation betrieben, was zu Instabilitäten und sogar zu dauerhaften Schäden an den Systemkomponenten führen kann. Shuttle lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch Übertaktung verursacht worden sind.

*****) Dynamisches Übertakten (D.O.C.)**

Dies ist eine im BIOS-Setup einstellbare Übertaktungsfunktion, die automatisch die CPU-Taktfrequenz in Abhängigkeit von der Belastung verändern kann. Falls eine erhöhte CPU-Auslastung festgestellt wird, dann wird die Taktfrequenz automatisch etwas angehoben, damit die Programm flüssiger und schneller laufen. Falls sich die CPU im Ruhemodus befindet oder nur wenig beansprucht wird, dann wird die Taktfrequenz auf einem normalen Wert belassen.

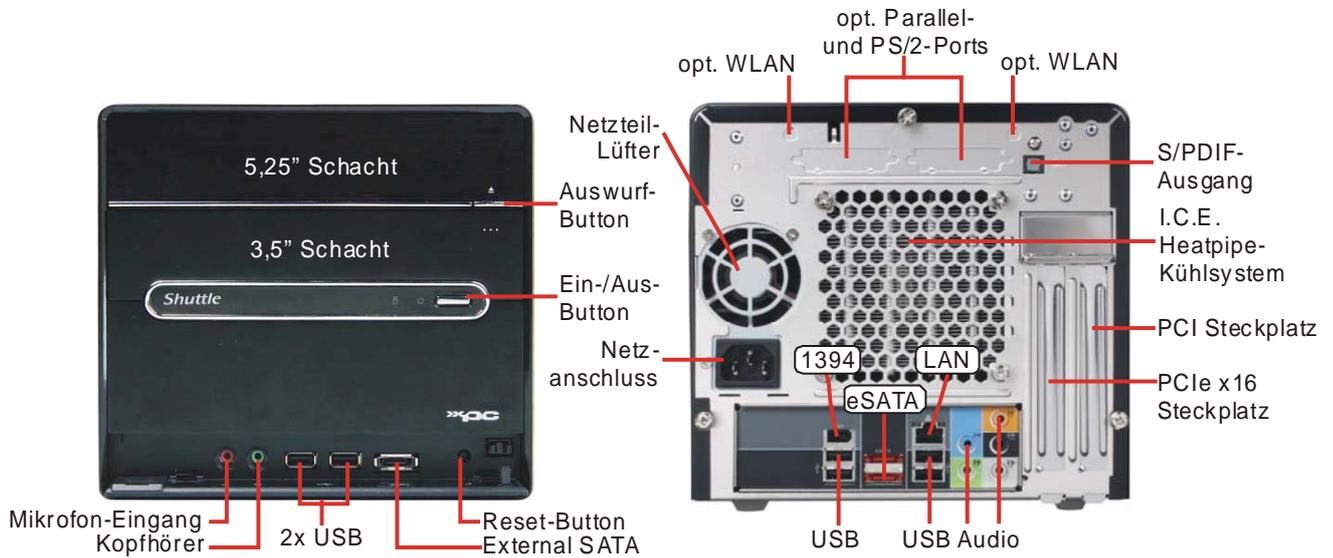
******) Dynamic Energy Saving (D.E.S.)**

Diese Energiespar-Technologie verbessert die Energie-Effizienz des PC-Systems und vermindert die Hitzeentwicklung im PC-Gehäuse. Mit Hilfe eines speziellen Chips wird die CPU-Auslastung über das PSI-Signal der CPU (Power State Indicator) überwacht und bei geringer Belastung 3 der 4 Phasen des CPU-Spannungsreglers abgeschaltet. Diese fortschrittliche hardware-basierende Technologie spart nicht nur Energie, sondern führt auch zu einem geringeren Betriebsgeräusch.

Shuttle XPC Barebone SP45H7 – Anschlüsse und Komponenten

Vorderseite

Rückseite



Backpanel-Anschlüsse

Mainboard

